

一、營運回顧與財務展望主軸 世界先進 2026 年第二季的各項財務指標全數達標，晶圓出貨量季增 11% 到 13%，平均銷售單價 (ASP) 季增 2% 到 4%，毛利率落在 31% 到 32% 之間。出貨量呈現雙位數成長的底層邏輯在於第二季逐步進入半導體傳統旺季，且 AI 伺服器與終端需求暢旺，帶動相關電源管理 IC 的需求急遽增加。在地緣政治因素下，美系客戶將智慧型手機訂單由中國轉移至台灣，使世界先進在電源管理產品的成長率遠優於公司平均，達到逾 10% 甚至 20% 的水準。相較之下，面板驅動 IC (DDIC) 的表現相對平淡，產品組合比重有所下降。獲利能力方面，產能利用率從第一季的約 80% 提升至第二季的 85% 到 90%。雖然面臨年度調薪與夏季電費等不利因素，但在產能利用率躍升、產品組合優化與年初第一輪報價調漲的加乘下，毛利率仍從第一季的 29%+ 逆勢成長至約 32%。

展望 2026 年第三季，訂單能見度維持 4 個月，整體產能利用率將優於第二季，但受限於產能瓶頸，增幅不會像第一季跨入第二季那般顯著。其中，0.18 微米及先進製程目前已達 100% 滿載，已無多餘產能可供分配；而主要供應車用需求的 0.35/0.5 微米製程則維持較低基期，利用率約為 78%。受惠於產能轉移與電源管理產品佔比增加，ASP 預計將維持往上趨勢。儘管面臨第三季完整的夏季電費及矽晶圓 (SiC inflation) 材料成本上調壓力，但在利用率與單價雙升、新台幣匯率相對有利的支撐下，毛利率有望持續轉佳。

就 2026 全年營運目標而言，全年產能利用率預估將落在 80% 到 90%+ 區間，大幅優於去年的平均 75%。晶圓出貨量有高機率達到雙位數成長，全年 ASP 也有望迎來年增個位數百分比。在量價齊揚的帶動下，公司維持今年度營收(以美金計價)成長約 20% 的目標不變。

二、產能規劃、資本支出與技術推進 在產能變動方面，今年度月平均產能約為 27.7 萬片 (277K)，較去年的 28.7 萬片 (287K) 減少 4%。產能減少的底層技術邏輯在於公司正將部分 0.35/0.5 微米產能升級為 0.18 微米。由於 0.35/0.5 微米產品通常只需約 20 幾層光罩，而 0.18 微米製程的層數高達 30 幾層，生產工序變長，導致總體晶圓產出片數自然會減少。

資本支出方面，今年度預估介於新台幣 600 億至 700 億元之間，為現金流出的高峰年。其中 85% 到 90% 用於 12 吋廠的廠房建設與機器設備預付貨款；剩餘 10% 到 15% 則用於 8 吋廠的年度例行性汰舊換新、0.18 微米去瓶頸工程以及產能升級。今年度折舊金額約落在新台幣 95 億至 96 億元之間，其中 95% 到 98% 皆來自 8 吋廠，12 吋廠要到下半年才會有極少部分的廠房折舊攤提。

三、12吋晶圓廠重大進展與戰略調整 12 吋晶圓廠的重大進展在於與台積電簽訂了技術授權合作，將導入 Interposer (矽中介層) 製程，作為台積電 CoWoS 封裝技術中的一環，且台積電將全數提供相關的機器設備。這項資源配置的大幅優化使 12 吋廠的資本支出由原先預估的 68 億美元大幅下降至 57 億美元。產能規模也從原先規劃的純 IC 製造 (55,000 片/月)，變更為「IC + Interposer」共 44,000 片/月。

目前 12 吋廠 100% 的產能皆已簽訂 LTA。預計於 2027 年開始量產，年底產能目標突破 2 萬多片；至 2028 年底或 2029 年初將達 44,000 片滿載。受惠於產品組合調整，損益兩平點大幅提前，預計 2028 年上半年即可達到損益兩平，2028 全年即有機會開始獲利。公司也重申長期財務目標不變，在 12 吋滿載狀況下，2029 年營收將達到 2025 年的兩倍。

四、Q&A 問答整理

問題 1:關於 12 吋廠全產能開出後, 2029 年營收將翻倍。目前 12 吋產能僅 44K, 這是否意味著 12 吋的 ASP 是 8 吋的 6 倍之多? 答案 1:我們不便透露具體倍數, 但單價確實非常高。業界普遍認知 130 奈米至 40 奈米的平均單價約 1000 多美元, 而世界先進的 12 吋產品單價確定會高於此業界數字。然而, 營收翻倍並非全靠 12 吋, 2025 年 8 吋產能利用率預估僅 75%, 未來幾年 8 吋的利用率必然會回升, 因此這 100% 的營收成長是由「8 吋利用率提升」與「12 吋高單價新產能」共同貢獻的結果。

問題 2:請教 2027 年折舊增加的幅度與規劃? 答案 2:具體數字須待明年 1 月法說會才明朗, 但底層邏輯如下:今年的 90 幾億折舊主要為 8 吋, 未來將以 90 幾億降至 80 幾億、再降至 70 幾億的趨勢逐年遞減。12 吋折舊(以 57 億美元計算)中, 廠務設施約佔 40% (近 700 億台幣), 廠房攤提 50 年、設施攤提 20 年, 明年起預計每年需攤提約 25 億至 26 億台幣。機器設備約佔 60%, 44K 滿載的設備折舊一年約 100 億台幣(採 10+1 年攤提), 若明年平均開出 11,000 片, 設備折舊約為 25 億台幣。因此, 明年預估新增的 12 吋折舊約為 50 億台幣, 加上原有的 90 幾億, 整體折舊將顯著上升, 且因產能是年底才開出, 折舊壓力將集中在明年下半年。

問題 3:關於公司五年股息規劃, 既然 12 吋在 2028 年就獲利, 2029 年是否會增加股息發放? 答案 3:維持「至少 4.5 元, 一旦增加就不減少」的發放原則不變。增發的條件取決於絕對 EPS 增加幅度, 以及增加後的 DPS 是否能在未來五年持續維持。若 EPS 成長至 5 元, 目前配 4.5 元的發放率已達 90%; 若 EPS 實質成長至 6 元, 公司便有信心考慮將股息調高至 4.8 或 5 元。目前需視 2027、2028 年的實際獲利幅度而定。

問題 4:12 吋導入 Interposer 後, 預計長期的營收佔比為何? 答案 4:因單一客戶(台積電)關係, 無法透露確切營收佔比。但推論上, Interposer 專案使總資本支出下降約四分之一, 暗示其佔用產能比例可能相近; 然而 Interposer 屬高單價產品, 因此營收貢獻佔比與產能佔比將會有差異。

問題 5:後續針對客戶的「漲價」想法與目標? 答案 5:為維持獲利能力, 目前已啟動與客戶洽談 2026 年第二輪晶圓報價調漲。策略上, 公司會緊密觀察同業報價區間進行 Benchmark, 確保客戶在終端市場仍具競爭力, 創造供應鏈雙贏。漲價幅度預期將與市場水準約略相當。

問題 6:請教未來幾年營收的預期路徑? 答案 6:若以 2029 年營收翻倍為目標, 概念上就是透過 CAGR 約 20% 的直線成長每年穩定堆疊。核心動能來自於 12 吋產能開出, 且因具備長約 (LTA)、預付貨款及客戶設備進駐等條件, 公司對維持高產能利用率極具信心。

問題 7:市場傳聞 T 公司(台積電)將轉移大量 8 吋訂單給世界先進, 公司是否有進一步大幅擴充 8 吋產能的計畫? 答案 7:目前台灣與新加坡的廠房物理空間, 合計最多僅能再擴充 2 萬片產能。若要承接訂單, 還需評估能否買到成本合宜的二手設備。公司傾向優先從現有產能做產品組合的質的改良, 確保投資報酬率後才行動, 避免過度擴張帶來的風險。

問題 8:目前工業用與車用市場的終端需求狀況如何? 答案 8:工業用需求自去年開始逐步復甦, 目前維持溫和正向, 但缺乏如 3C 產品強烈的季節性拉貨力道。車用需求持續處於低基期, 去年上半年中國曾有電動車補貼帶動急單, 但補貼結束後, 目前中國及其他區域的車用需求皆相對疲軟。

問題 9:之前提到新加坡新廠在 2027 年會對毛利率造成「雙位數影響」, 能否再更新預估? 答案 9:基於 85% 利用率、35% 結構性毛利率的基準下, 2027 年新廠對毛利率的稀釋約為中高個位數百分點; 2028 年收斂至中個位數百分點; 2029 年進一步收斂至中低個位數百分點。此基準線將隨未來實際利用率及單價走勢而動態調整。

問題 10:2027 年先開出的 22K 產能中, 是 Interposer 還是自有的 IC 製程會先上線? 答案 10:兩者在今年度都會同步開始驗證, 2027 年兩種需求皆存在。營收佔比將取決於裝機與認證速度, IC 使用自購設備, Interposer 則由台積電進駐設備。長期回歸 2028、2029 的常態, 仍會以傳統 IC 為絕大部分, 但 Interposer 也佔有不容小覷的比重。

問題 11:市場熱烈討論 IPD (矽電容) 產品, 貴公司 12 吋有在進行相關驗證嗎? 答案 11:8 吋廠目前有做部分矽電容產品, 但產能已供不應求。在 12 吋部分, 44K 產能已被 Analog / Mixed Signal 及 Interposer 預訂一空。雖有客戶表達合開新技術的意願, 但在產能受限且無法給予產能承諾的現狀下, 暫不考慮投入。

問題 12:目前 8 吋產能利用率滿載, 若這波缺貨超過一年, 客戶將現有成熟產品轉向 12 吋生產的意願會變高嗎? 答案 12:意願不會太高。底層物理邏輯在於世界先進主打的高壓製程具備高電壓、高電流特性, 技術轉移難度極高, 預估未來五到七年, 七八成的訂單仍會留在 8 吋的 0.15/0.13 微米節點。此外, 12 吋同業的 90 奈米設備雖可向下相容 0.15 微米, 但在 12 吋成熟製程滿載下, 同業寧可用設備生產利潤更好的 90/65 奈米產品, 因此市場雖緊但不到逼迫客戶強行轉換的程度。

問題 13:未來產品組合優化的幅度還有多大空間? 答案 13:將是漸進式的過程。許多工控、車用的分離式元件必須長期待在 0.35/0.5 微米製程, 今年最多只能轉移約 1 萬多片至 0.18 微米。此外, 0.35/0.5 微米目前佔營收 25%, 但因光罩層數少, 實際佔用了超過 30% 的機台產能。將其轉為 0.18 微米時, 電源管理需要更多金屬層, 驅動 IC 需要更多多晶矽層, 這會造成部分設備閒置或瓶頸, 因此產能比重的轉換需要時間磨合。

問題 14:2029 年之後, 12 吋廠的毛利率會高於還是低於公司平均? 答案 14:會低於公司平均。主要原因是未來幾年 8 吋折舊陸續到期, 佔成本結構比重將從目前的 20 幾 % 降至十幾個百分點。而 12 吋設備採用 10+1 年攤提, 其折舊佔該廠成本結構將高達 40% 到 50%, 這筆長達十年的龐大固定成本會稀釋總體毛利率, 不過絕對金額的 EBITDA 將遠勝於 8 吋。

問題 15:目前的 8 吋漲價氛圍, 與 2022 年極盛時期相比感覺如何? 答案 15:尚未達到 2022 年瘋狂程度。2022 年是全面缺貨、產能競標且每季漲價 10% 以上;目前漲幅多在 5% 到 10% 之間, 談判頻率從每季拉長至每半年一次。現在主要是 AI 相關晶片大缺, 但 PC、手機及車用等終端需求並未全面噴發。

問題 16:現在的報價水位大概是以前最高峰的七八成嗎? 答案 16:從 2020 到 2023 年上半年, 成熟製程報價平均漲幅約在 30%+, 但這 30% 漲幅在 23 下半年至 25 年間已全數回吐。自 2025 下半年, 中國同業率先拉高了 10% 到 20% 報價, 其他區域則在今年緩步跟進個位數漲幅。但過去五年內生產成本已攀升了 20% 到 30%, 目前的報價回升尚不足以完全彌補過去幾年吸收的成本通膨。

問題 17:公司認為這波漲幅落在什麼區間是客戶能夠全數吸收的? 答案 17:上游矽晶圓供應商也面臨利潤壓力並要求調漲報價。公司的策略是透過分散採購 (台系、日系、中系), 利用較便宜的中國矽晶圓平抑材料成本。面對漲價要求, 公司會先進行議價協商, 接著嘗試將增加的成本轉嫁給下游客戶, 最終能漲多少取決於市場供需與雙方的議價能力。

問題 18:請教目前的客戶區域佔比分佈? 答案 18:美國客戶約佔 30% 到 40% (包含 PMIC 的 Fabless 及 IDM 廠);日本客戶約佔 20%;台灣客戶約佔 20% (主要為面板驅動及電源管理);中國客戶約佔 10% 到 15%;歐洲客戶接近 10% (主要為 IDM 廠)。

問題 19: 公司的成本結構佔比大概為何? 答案 19: 薪資佔最大宗, 約 30%; 折舊約 25%; 直接材料與間接材料各約 10% (合計 20%); 水電費接近 15%; 剩餘約 10% 為其他製造費用。